

晶圆（硅片）微电镀机（MP-01AR）

设备编号为 MP-01AR 的晶圆（硅片）电镀机是微构龙科技(MST)专门为半导体/MEMS/LED 等微电子领域设计和制造的，适合高等院校和研发单位进行 6inch 及以下晶圆电镀 Au, Ag, Cu, Ni, Sn 工艺的研发和小批量生产使用。



设备正面



设备侧面

设备技术指标和功能描述

1	槽体材料	德国进口劳士领瓷白 PP 材料。
2	槽体结构	分为储存区和功能区，四面溢流设计。
3	循环系统	进口磁力泵，配备流量调节装置
4	温控系统	70°C+/-1°C，配备铁氟龙 1200W 加热器。
5	过滤系统	过滤精度 ≤1μm，配备 PP 折叠过滤器和碳纤维过滤器
6	阳极系统	对于金电镀：Pt/Ti； 对于其他电镀：Ti basket； 均配备 PP 过滤袋。
7	阴极系统	MST 专用夹具，316 不锈钢和 PVDF 材料，配备 Ti 电极。
8	阴极摆动	进口气缸，驱动阴极前后摆动。摆动的频率可调。
9	液位报警	液位达不到要求，设备加热和循环功能自动停止，防止误操作
10	均化装置	Ni 电镀工艺专配，提高工艺均匀性。



11	打气装置	Ag 电镀工艺专配，提高阳极效率。
12	防氧化	槽体密封上盖以及 N2 保护系统。
13	排水系统	位于设备下方。
14	电镀电源	标准配置：DC 18V/5A； 其他功能电源可选配。
15	控制面板	位于设备后上方，控制项目包括电源开关，温度控制系统，循环系统，和阴极驱动控制，以及保护气控制以及液位报警系统等。
16	动力条件	220V/2.0KW/N2； 良好的通风环境，

工艺应用描述

1	工艺种类	Au, Ag, Cu, Ni, Sn
2	工艺应用	半导体 / MEMS / LED 等领域，晶圆电镀。
3	晶圆尺寸	6inch 及以下尺寸晶圆。
4	生产能力	单片操作
5	夹具装卸时间	操作方便，小于 1min
6	工艺温度	最高 70°C+/-1°C
7	过滤精度	≤1um
8	电镀电源	DC DC 18V/5A，精度 10mV/1.mA
9	电镀层厚度	最大厚度 100um
10	电镀速率	0.3-1.0um，
11	电镀液体系	均为无氰电镀液体系
12	咨询	每种电镀工艺的具体内容可咨询供应商

联系方式

对设备和工艺如有任何问题和建议，请通过以下方式联系我们，我们将为您提供更详细咨询和服务。

联系人：高先生

邮箱：mst168@126.com

电话：0755 22303270

手机：13699877985